(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特期2001-294570 (P2001-294570A)

(43)公開日 平成13年10月23日(2001.10.23)

の以出籍来は	=	#\$##2000 ~ 333088€ D20	000 000000)	(71) H	- NCM - E	000004	~~~		
			客查請求	有	請求	項の数7	OL	(全 15 頁)	最終頁に続く
G03F	7/004	503		G 0 3	F	7/004		503A	
	335/02				3	35/02			4H006
	333/46				3	33/46			4 C 0 6 2
C 0 7 D	311/22			C 0 7	D 3	311/22			4 C 0 2 3
C07C	381/12			C 0 7	C 3	81/12			2H025
(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ				テ	~73~}*(参考)

(21)出願番号 特額2000-332968(P2000-332968)

平成12年10月31日(2000.10.31) (22)出顧日

(31)優先権主張番号 特顧平11-310827

(32)優先日 平成11年11月1日(1999.11.1)

(33)優先權主張国 日本 (JP)

(31) 優先権主張番号 特顧2000-33652 (P2000-33652)

平成12年2月10日(2000.2.10) (32)優先日

(33)優先権主張国 日本 (JP) (71)出版人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 前田 勝美

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72) 発明者 岩佐 繁之

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 100088328

弁理士 金田 暢之 (外2名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 スルホニウム塩化合物、フォトレジスト組成物、およびそれを用いたパターン形成方法

(57)【要約】

【課題】 波長220 n m以下の紫外光に対して透明 性が良く、かつ光反応効率(光酸発生効率)が高く、1 30~220nmの波長の露光に対応した化学増幅型レ ジスト材料に利用される新規な光酸発生剤の提供。

【解決手段】 本発明の光酸発生剤は、下記一般式

(1):

(化1)

$$R^{1}$$
 R^{2}
 R^{3}
 R^{5}
 R^{4}
 R^{5}
 R^{4}
 R^{5}
 R^{5}

(式中、R1、R1はそれぞれ独立に、直鎖または分枝の アルキル基、単環式または橋架け環式の環状アルキル 基、または、R'とR'が互いにつながり環を形成した基 あるいは前記環上にオキソ置換された基、R1、R1、R1、R 1、R1はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ア ルキル基、アルコキシ基、Xは-CH,-、-C,H,-

または-OCH,-、Y-は対イオンを表す)で示される スルホニウム塩化合物である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(1):

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
R^3 & Q & R^1 \\
R^5 & X & Y^- \\
R^6 & & (1)
\end{array}$$

1

(式中、

R¹、R¹は、それぞれ独立に、直鎖のアルキル基、分枝 のアルキル基、単環式の環状アルキル基および橋架け環 式の環状アルキル基からなる群から選択される基、また は、前記の飽和炭素骨格を有するR1、R1が互いにつな がり環を形成した基、あるいは、R1、R1が互いにつな がり環を形成し、さらにオキソ置換がなされた基であ

R'、R'、R'、R'は、それぞれ独立に、水素原子、ハ ロゲン原子、炭素数1~4のアルキル基、アルコキシ基 からなる群から選択される基であり、

Xは、-CH₂-、-C₂H₄-、-OCH₂-(但し、-OCH、-はオキシ基とベンゼン環が結合する) からな る群から選択される基であり、

Y-は対イオンを表す)で示されるスルホニウム塩化合

【請求項2】 Y-で表される対イオンが、

下記一般式(II):

【化2】

$$C_{n}F_{2n+1}SO_{3}^{-} \qquad (II)$$

フルオロアルキルスルホナート イオン、

下記一般式(III):

[化3]

$$C_k H_{2k+1} S O_3^-$$
 (III)

(式中、kは1~9の正の整数を表す)で示されるアル キルスルホナート イオン、ベンゼンスルホナート イ オン、アルキルベンゼンスルホナート イオン、フッ素 置換ベンゼンスルホナート イオン、フッ素置換アルキ ルベンゼンスルホナート イオン、BF。、AsF。、 SbF。、PF。、Br、I-からなる群から選択され 40 る陰イオン種であることを特徴とする請求項1に記載の スルホニウム塩化合物。

【請求項3】 スルホニウム塩化合物を光酸発生剤とし て含有するポジ型フォトレジスト組成物であって、前記 スルホニウム塩化合物として、請求項1または2に記載 のスルホニウム塩化合物を用いることを特徴とするポジ 型フォトレジスト組成物。

【請求項4】 スルホニウム塩化合物を光酸発生剤とし て含有するネガ型フォトレジスト組成物であって、前記 のスルホニウム塩化合物を用いることを特徴とするネガ 型フォトレジスト組成物。

【請求項5】 フォトレジスト組成物の露光に、波長1 30~220nmの範囲から選択する露光光を用いるバ ターン形成方法であって、

パターン形成を行う被加工基板上に請求項3 に記載のポ ジ型フォトレジスト組成物または請求項4に記載のネガ 型フォトレジスト組成物を塗布する工程、

前記露光光を用いて所望のパターンを前記フォトレジス 10 ト組成物の塗布皮膜に露光する工程、

露光後に、前記フォトレジスト組成物の塗布皮膜にベー ク処理を施す工程、ならびに、ベーク処理を施した前記 フォトレジスト組成物の塗布皮膜に現像処理を施す工程 を含むことを特徴とするパターン形成方法。

【請求項6】 波長130~220nmの範囲から選択 する露光光としてArFエキシマレーザ光を用いること を特徴とする請求項5記載のパターン形成方法。

【請求項7】 波長130~220nmの範囲から選択 する露光光としてF、エキシマレーザ光を用いることを 20 特徴とする請求項5記載のパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、化学増幅型フォト レジスト材料用光酸発生剤として利用できる新規なスル ホニウム塩化合物、ならびに、係る新規なスルホニウム 塩化合物を光酸発生剤として添加する化学増幅型フォト レジスト組成物、前記フォトレジスト組成物をパターン 形成に利用する方法に関する。より具体的には、露光波 長を130 n m以上220 n m以下の遠紫外から真空紫 (式中、mは1~9の正の整数を表す)で示されるパー 30 外の領域とする化学増幅型フォトレジスト材料用光酸発 生剤として、好適に利用できる新規なスルホニウム塩化 合物に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体デバイス、例えば、DRAM(ダ イナミック・ランダム・アクセス・メモリ)などに代表 される高集積回路素子では、一層の高密度、高集積化、 あるいは高速化の要望が高い。それに伴い、各種電子デ パイス製造分野では、ハーフミクロンオーダーの微細加 工技術の確立、例えば、微細パターン形成のためのフォ トリソグラフィー技術開発に対する要求がますます厳し くなっている。

【0003】フォトリソグラフィー技術において、パタ ーンの微細化を図る手段の一つは、レジストのパターン 形成の際に使用する露光光の波長を短くする方法があ る。一般に、光学系の解像度(R)はレイリーの式、R = k· A / NA(ととで、 A は露光光源の波長、 NA は レンズの開口数、kはプロセスファクター)で表すこと ができる。パターンの微細化を進めるためには、用いる 光学系をより高解像度とする必要があり、すねわち光学 スルホニウム塩化合物として、請求項1または2に記載 50 系の解像度Rの値を小さくする際には、露光光の波長 A

を短くする必要がある。

【0004】例えば256メガビットの集積度のDRA Mの製造では、最小パターン寸法0.22μmライン-アンドースペースの解像度が要求され、従ってKrFエ キシマレーザ(波長248nm)が光源として使用され ている。次世代の1ギガビット以上の集積度を持つDR AMの製造では、加工寸法が0.15μm以下となり、 さらに微細な加工技術を必要とするため、ArFエキシ マレーザ (193nm)、F₁エキシマレーザ (157 nm) などのより短波長の光(遠紫外光、真空紫外光) の利用が有効であり、かつ必要となると考えられてい る。現在では、ArFエキシマレーザリソグラフィが盛 んに研究されている [ドナルド C. ホッファーら、ジ ャーナル・オブ・フォトポリマー・サイエンス・アンド ·テクノロジー(Journal of Photop olymer Science and Techno logy)、9巻(3号)、387頁~397頁(19 96年)などを参照]。

3

【0005】一方ArFエキシマレーザやF、エキシマ レーザを用いる場合、これらのレーザに利用するガスの 20 寿命が短いこと、レーザ光によるレンズのダメージが大 きいことなどから、露光用レジストの開発に際しては、 加工寸法の微細化に対応する高解像性に加え、高感度化 への要求が高い。レジストの髙感度化の方法として、感 光剤である光酸発生剤を利用する化学増幅型レジストが 良く知られている。例えば、現在知られている代表的な 例として、特開平2-27660号公報に記載される、 ポリ(p-tert-ブトキシカルボニルオキシ-α-メチルスチレン)と光酸発生剤のトリフェニルスルホニ なるレジストなどが挙げられる。このような化学増幅型 レジストは、現在KrFエキシマレーザ用レジストに広 く用いられている [例えば、ヒロシ イトー、C. グラ ントウイルソン、アメリカン・ケミカル・ソサイアティ ・シンポジウム・シリーズ 242巻、11頁~23頁 (1984年)などを参照]。

【0006】化学増幅型レジストの特徴は、含有成分である光酸発生剤から光照射によりプロトン酸が発生し、このプロトン酸が露光後の加熱処理によりレジスト樹脂などと酸触媒反応を起こすことである。この酸触媒作用 40を利用することで、光反応効率(一光子あたりの反応)が1未満の従来のレジストに比べて飛躍的な高感度化を達成している。現在では、開発されているレジストの大半は、化学増幅型である。現在使用されている光酸発生剤の例として、ジャーナル・オブ・ジ・オーガニック・ケミストリー(Journal of the Organic Chemistry)43巻、15号、3055~3058頁(1978年)に記載されているJ. V. クリベロ(J. V. Crivello)らが開発したトリフェニルスルホニウム塩誘導体が挙げられる。50

[0007]

(3)

【発明が解決しようとする課題】既に提案されているA r F エキシマレーザ用化学増幅型レジストに利用される 光酸発生剤の代表的なものは、トリフェニルスルホニウ ム塩誘導体である [例えば、野崎ら、ジャーナル・オブ ・フォトポリマー・サイエンス・アンド・テクノロジー (Journal of Photopolymer Scienceand Technology) 10 巻、4号、545~550頁(1997年)、あるいは Yamachikaら、ジャーナル・オブ・フォトポリ マー・サイエンス・アンド・テクノロジー(Journ al of Photopolymer Scienc e and Technology) 12巻、4号、5 53~560頁(1999年)などを参照]。しかしな がら、これらのトリフェニルスルホニウム塩誘導体は、 220 n m以下の光を強く吸収するため、トリフェニル スルホニウム塩誘導体を光酸発生剤として用いた場合、 レジストの透明性が低くなり、それに伴い解像性が低下 するとう問題を有している [例えば、内藤卓也、第8回 光反応・電子用材料研究会講座、講演要旨集、16~1 8頁(1999年)などを参照]。

【0008】そのため、ArFエキシマレーザに代表される130~220nmの波長の露光に対応したレジスト材料の開発において、現在研究開発の対象となっている技術的課題の一つは、波長220nm以下の紫外光に対して透明性が良く、かつ光反応効率(光酸発生効率)が高い光酸発生剤の開発である。

(光酸発生効率)が高い特質を有する新規な構造のスルホニウム塩化合物を提供することである。

[0010]

【課題を解決するための手段】発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意研究を進め、種々の新規な構造のスルホニウム塩化合物を創出し、その特性を調べたところ、従来のトリフェニルスルホニウム塩誘導体の種々のフェニル基に換えて、1-オキソインダン-2-イル基または種々の置換1-オキソインダン-2-イル基、1-テトラロン-2-イル基または種々の置換1-テトラロン-2-イル基、あるいは4-クロマノン-2-イル基を含

む、以下に述べる一般式(1)で示されるスルホニウム 塩化合物は、光反応効率(光酸発生効率)が高く、加え て、波長220 nm以下の紫外光に対する透明性も優れ るととを見出し、本発明を完成するに至った。

【0011】すなわち、本発明のスルホニウム塩は、下 記一般式(1):

[0012]

(化4)

【0013】(式中、R1、R1は、それぞれ独立に、直 鎖のアルキル基、分枝のアルキル基、単環式の環状アル キル基および橋架け環式の環状アルキル基からなる群か ら選択される基、または、前記の飽和炭素骨格を有する R¹、R²が互いにつながり環を形成した基、あるいは、 R¹、R¹が互いにつながり環を形成し、さらにオキソ置 20 換がなされた基であり、R¹、R¹、R¹、R¹は、それぞ れ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~4のア ルキル基、アルコキシ基からなる群から選択される基で あり、Xは、-CH₂-、-C₂H₄-、-OCH₂-(但 し、-ОСН,-はオキシ基とベンゼン環が結合する) からなる群から選択される基であり、Y-は対イオンを 表す)で示されるスルホニウム塩化合物である。

【0014】なお、前記Y-で表される対イオンは、一 般式(II):

[0015]

【化5】

$$C_{m}F_{2m+1}SO_{3}^{-} \qquad (II)$$

【0016】(式中、mは1~9の正の整数を表す)で 示されるパーフルオロアルキルスルホナート イオン、 一般式(III):

[0017]

【化6】

$$C_k H_{2k+1} SO_3^-$$
 (III)

【0018】(式中、kは1~9の正の整数を表す)で ホナート イオン、アルキルベンゼンスルホナート イ オン、フゥ素置換ベンゼンスルホナート イオン、フゥ 素置換アルキルベンゼンスルホナート イオン、B F. As F. Sb F. PF. Br. I-bst る群から選択される陰イオン種とすると好ましい。 【0019】本発明のポジ型フォトレジスト組成物は、

スルホニウム塩化合物を光酸発生剤として含有するポジ 型フォトレジスト組成物であって、前記スルホニウム塩 化合物として、上記本発明のスルホニウム塩化合物を用 いることを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物であ 50 ターン転写の際高い解像度が得られる。

る。また、本発明のネガ型フォトレジスト組成物は、ス ルホニウム塩化合物を光酸発生剤として含有するネガ型 フォトレジスト組成物であって、前記スルホニウム塩化 合物として、上記本発明のスルホニウム塩化合物を用い ることを特徴とするネガ型フォトレジスト組成物であ

【0020】本発明のフォトレジスト組成物を用いたバ ターン形成方法は、フォトレジスト組成物の露光に、波 長130~220nmの範囲から選択する露光光を用い 10 るパターン形成方法であって、パターン形成を行う被加 工基板上に上記の本発明のポジ型フォトレジスト組成物 またはネガ型フォトレジスト組成物を塗布する工程、前 記露光光を用いて所望のバターンを前記フォトレジスト 組成物の塗布皮膜に露光する工程、露光後に、前記フォ トレジスト組成物の塗布皮膜にベーク処理を施す工程、 ならびに、ベーク処理を施した前記フォトレジスト組成 物の塗布皮膜に現像処理を施す工程を含むことを特徴と するパターン形成方法である。なお、前記波長130~ 220nmの範囲から選択する露光光として、波長19 3nmのArFエキシマレーザ光、あるいは、波長15 7 n mのF,エキシマレーザ光を用いることができる。 [0021]

【発明の実施の形態】本発明のスルホニウム塩化合物 は、上記一般式(I)で示される構造を有するが、その 特徴はスルホニウム塩が、1-オキソインダン-2-イ ル基または種々の置換1-オキソインダン-2-イル 基、1-テトラロン-2-イル基または種々の置換1-テトラロン-2-イル基、あるいは4-クロマノン-2 - イル基または種々の置換4-クロマノン-2-イル基 30 から選択する環基と、R1、R1で示される各種アルキル 基などで構成される点に特徴がある。露光自体は、1-オキソインダン-2-イル基または種々の置換1-オキ ソインダン-2-イル基、1-テトラロン-2-イル基 または種々の置換1-テトラロン-2-イル基、あるい は4-クロマノン-2-イル基または種々の置換4-ク ロマノン-2-イル基、これらの環基部分に由来する吸 収が利用される。一方、残るR1、R1で示される基に由 来する吸収は、上記する波長130~220nmの範囲 で非常に小さいため、本発明のスルホニウム塩化合物 示されるアルキルスルホナート イオン、ベンゼンスル 40 は、前記の波長220nm以下の紫外光に対して透明性 が優れたものとなる。加えて、露光に際して発生するブ ロトン酸: H'-Y'の生成率自体は、高く保たれたもの となる。化学増幅型フォトレジスト組成物中で起とる反 応、すなわち、この発生するプロトン酸:H'-Y'が触 媒する、レジスト樹脂における酸触媒反応自体は同じで ある。本発明のスルホニウム塩化合物は、波長220 n m以下の紫外光に対して透明性が優れるため、レジスト 膜中の深くまでより均一に露光光が達し、従って、膜深 さ方向により均一なプロトン酸の発生が起とるため、バ

【0022】本発明のスルホニウム塩化合物において、 一般式(I)のスルホニウム基に置換するR1、R1は、 各々独立して直鎖状、分枝状、単環式、あるいは橋架け 環式アルキル基、より具体的には、メチル基、エチル 基、プロビル基、プチル基、ペンチル基、ヘキシル基、 ヘプチル基等の直鎖のアルキル基、イソブロビル基、イ ソプチル基、tert-ブチル基などの分枝のアルキル基、 シクロベンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル 基、シクロオクチル基などの単環式のシクロアルキル 基、ノルボルニル基、イソボルニル基、アダマンチル 基、トリシクロデシル基、テトラシクロドデシル基など の橋架け環式アルキル基などが好適な基の例として挙げ られる。加えて、R1、R1が互いに結合して環を形成し ても良く、その際には、上記炭素骨格を含む二価の基: -R1-R3-となるが、より具体的には、テトラメチレ ン基、ペンタメチレン基などのアルキレン基、これらの アルキレン基にさらにオキソ置換がなされている、2-オキソテトラメチレン基、3-オキソペンタメチレン基 などのオキソアルキレン基などが好適な基の例として挙 に形成する環は、好ましくは4員環~8員環、より好ま しくは5員環または6員環を構成するとよい。なお好適 な基は、前記する具体的な基に限定されるものではな 610

【0023】一般式(I)の環基、すなわち、1-オキ ソインダン-2-イル基、1-テトラロン-2-イル 基、あるいは4-クロマノン-2-イル基上のR³から R⁶は、水素原子、ハロゲン原子、より具体的には、フ ッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等、炭素数 1~4のアルキル基、より具体的には、メチル基、エチ ル基、プロビル基、イソプロビル基、プチル基、イソブ チル基、tert-ブチル基等、炭素数1~4のアルコキシ 基、より具体的には、メトキシ基、エトキシ基、ブトキ シ基等が挙げられる。とれら具体的な基は、好適な基の 一例であるが、好適な基はこれらだけに限定されるもの ではない。

【0024】一般式(I)で示されるスルホニウム塩化 合物中、Y⁻で示される対イオンは、先に述べたように 露光に際して、プロトン酸:H'-Y'となる。実際の触 媒作用は、用いるレジスト樹脂に応じて、自ずから定ま 40 ン)などの種々のフッ化物イオン、並びにBェー(臭化 るものである。従って、用いるレジスト樹脂に応じて、 従来よりこの種の光酸発生剤に用いられている陰イオン 種Y-を選択することができる。より具体的には、一般 式(II):

[0025]

【化7】

$$C_m F_{2m+1} S O_3^- \qquad (II)$$

【0026】(式中、mは1~9の正の整数を表す)で 示されるパーフルオロアルカンスルホナート イオン、 例えば、CF,SO, (トリフルオロメタンスルホナー

ト イオン)、C.F.SO, (ノナフルオロブタンスル ホナート イオン)、 C, F,, SO, (ヘプタデカフル オロオクタンスルホナート イオン) 等が好適な例とし て挙げられる。なお、好適なパーフルオロアルカンスル ホナート イオンはこれらだけに限定されるものではな い。同じく、一般式(III):

[0027]

[化8]

$$C_k H_{2k+1} SO_3^-$$
 (III)

10 【0028】(式中、kは1~9の正の整数を表す)で 示されるアルカンスルホナート イオン、例えば、CH ,SO, (メタンスルホナート イオン)、C,H,SO, (エタンスルホナート イオン)、 $C_{\bullet}H_{17}SO_{7}^{-}(1)$ ーオクタンスルホナート イオン)、C,H,,SO , (1-ノナンスルホナート イオン) 等が好適な例と して挙げられる。なお、好適なアルカンスルホナート イオンはこれらだけに限定されるものではない。 【0029】また、ベンゼンスルホナート イオン、な らびにアルキルベンゼンスルホナート イオン、例え げられる。一般に、二価の基:-R¹-R¹-がSととも 20 ば、p-トルエンスルホナート イオン、キシレンスル ホナート イオン等が好適な例として挙げられる。な お、好適なアルキルベンゼンスルホナート イオンはこ れらだけに限定されるものではない。

> 【0030】同じく、フッ素置換ベンゼンスルホナート イオン、例えば、4-フルオロベンゼンスルホナート イオン、ペンタフルオロベンゼンスルホナート イオ ン等も好適な例として挙げられるが、好適なフッ素置換 ベンゼンスルホナート イオンはこれらだけに限定され るものではない。また、フッ素置換アルキルベンゼンス ルホナート イオン、例えば、4-トリフルオロメチル ベンゼンスルホナートイオン、3,5-ビス(トリフル オロメチル) ベンゼンスルホナート イオン等も好適な 例として挙げられる。但し、好適なファ素置換アルキル ベンゼンスルホナート イオンは、これらに限定される ものではない。

> 【0031】その他、BF、(テトラフルオロボラート イオン)、AsF。 (ヘキサフルオロアルセナート イオン)、SbF。 (ヘキサフルオロアンチモナート イオン)、PF。* (ヘキサフルオロホスファート イオ 物イオン)、 I - (ヨウ化物イオン) 等のハロゲン化物 イオンが、好ましい対イオンの例として挙げられる。な お、好適な無機陰イオン種は、これらに限定されるもの ではない。

【0032】本発明のスルホニウム塩化合物中、Y-で 表される対イオンは、先に述べたように露光に際して、 プロトン酸: H'-Y'となる。 このプロトン酸による酸 触媒作用が維持される必要があり、生成するプロトン酸 が露光後に実施されるベーク処理において、蒸発・飛散 50 などを起こさない対イオンを選択するとより好ましい。

【0033】本発明のフォトレジスト組成物は、ポジ型 フォトレジスト組成物及びネガ型フォトレジスト組成物 のいずれの構成をもとることができる。すなわち、本発 明のフォトレジスト組成物は、化学増幅型レジストであ り、光酸発生剤として本発明のスルホニウム塩化合物を 含み、レジストに用いる樹脂、及びこれらを溶解する溶 剤を主な構成成分とするものである。なお、ネガ型フォ トレジストでは、従来のネガ型フォトレジストと同様 に、露光部での樹脂の不溶化反応を促進させるための架 **極剤等を添加しても良い。**

【0034】本発明のフォトレジスト組成物において は、一般式(1)で表されるスルホニウム塩化合物を光 酸発生剤として用いる。その際、一種の化合物を単独で 用いられるが、二種以上を混合しても良い。この種の化 学増幅型レジストでは、光酸発生剤は樹脂に対して一定 の比率で添加混合させるものであり、溶剤は、樹脂、光 酸発生剤、その他の添加剤を均一に溶解させる役割を果 たす。また溶剤は、フォトレジスト組成物の粘性を調整 し、塗布性を所望の範囲とする目的で種々に選択され る。フォトレジスト組成物中に含まれる溶剤を除く、全 20 報に記載される下記一般式 (IV): 構成成分100重量部中、一般式(1)のスルホニウム 塩化合物を、通常0.2~30重量部、好ましくは1~ 15重量部含有させると良い。この含有率が0.2重量*

*部以上で十分な感度が得られ、パターンの形成が容易と なる。また30重量部以下であると、均一な塗布膜の形 成が容易になり、さらに現像後には残渣(スカム)が発 生しにくくなる。用いるレジスト樹脂の種類、一般式 (1) のスルホニウム塩化合物から生成するプロトン酸 による酸触媒反応性に応じて、前記の範囲内で適宜含有 率を選択するとよい。

【0035】また本発明のポジ型フォトレジスト組成物 においては、用いるレジスト樹脂には、露光波長、具体 10 的には220 n m以下の遠紫外から真空紫外の領域の光 に対して高透明であり、且つ酸の作用によりアルカリ現 像液に可溶化する樹脂を適当に設定して用いることがで きる。なお、フォトレジスト組成物中に含まれる溶剤を 除く、全構成成分100重量部中、樹脂の含有率は通常 60~99. 8重量部、好ましくは75~99重量部と するとよい。本発明のポジ型フォトレジスト組成物に好 ましく用いられる樹脂の一例として、下記の樹脂を挙げ ることができる。

【0036】例えば、特開2000-026446号公

[0037] [化9]

【0038】(式中、R'、R'、R'、R'1は、水素原 子またはメチル基、R10は、酸により分解する基、また は酸により分解する基を有する炭素数7~13の有橋環 式炭化水素基、R11は、水素原子、炭素数1~12の炭 化水素基、またはカルボキシル基を有する炭素数7~1 3の有橋環式炭化水素基を表す。

[0039] xc, x, y, zt, zh

%=1、0 < x < 1、0 < y < 1、 $0 \le z < 1$ を満たす任 意の数である。また重合体の重量平均分子量は2000 ~20000である) で示される樹脂、特許第285 6116号公報に記載される下記一般式(V):

[0040] 【化10】

【0041】(式中、R¹'、R¹'、R¹'は、水素原子ま たはメチル基、Mは、炭素数7~13の有橋環式炭化水 素基を有する基、R¹¹は、酸により分解する基、R¹′、 は水素原子、炭素数1~12の炭化水素基を表す。

1、0<k<1、0<m<1、0≦n<1を満たす任意 の数である。また重合体の重量平均分子量は2000~ 50 【0043】

20000である)で示される樹脂、ジャーナル・オ ブ・フォトポリマー・サイエンス・アンド・テクノロジ - (Journal of Photopolymer Science and Technology) 1 0巻、4号、545~550頁(1997年) に記載さ れる下記一般式(VI):

【化11】

$$\begin{array}{c|c}
R_{\overline{R}} & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^3 \\
\hline
 & CH^3 & CH^3 & CH^3 & CH^$$

【0044】(式中、R18は、メチル基またはエチル 基、R13は、ラクトン構造を有する基、また、a、bは*10 【化12】

11

*それぞれa+b=1、0<a<1、0<b<1を満たす 任意の数である。また重合体の重量平均分子量は200 0~20000である)で示される樹脂、ジャーナル ・オブ・フォトポリマー・サイエンス・アンド・テクノ ロジー(Journal of Photopolym er Science and Technolog y) 10巻、3号、511~520頁(1997年) に 記載される一般式(VII):

[0045]

【0046】(式中、c、d、eは、それぞれc+d+ e=1、0<c<1、0≤d<1、0<e<1を満たす 任意の数である。また重合体の重量平均分子量は200 0~20000である)で示される樹脂等が好ましい 樹脂の一例として挙げられる。なお、上記の髙透明性と 20 げることができる。 酸触媒に対する反応性を有する限り、ことに具体的に示 すポジ型のレジスト樹脂以外のものも同じく好適に用い ることができる。

【0047】また、本発明のネガ型フォトレジスト組成 物においては、用いるレジスト樹脂には、露光波長、具 体的には220 nm以下の遠紫外から真空紫外の領域の 光に対して高透明であり、且つ酸の作用によりアルカリ 現像液に不溶化する樹脂を適当に設定して用いることが できる。なお、フォトレジスト組成物中に含まれる溶剤※ ※を除く、全構成成分100重量部中、樹脂の含有率は通 常60~99. 8重量部、好ましくは70~99重量部 とするとよい。本発明のネガ型フォトレジスト組成物に 好ましく用いられる樹脂の一例として、下記の樹脂を挙

【0048】例えば、ジャーナル・オブ・フォトポリマ ー・サイエンス・アンド・テクノロジー (Journa l of Photopolymer Science and Technology) 12卷、3号、48 7~492頁(1999年) に記載される下記一般式 (VIII):

[0049]

【化13】

【0050】(式中、f、g、hは、それぞれf+g+ h=1、0≤f<1、0<g<1、0≤h<1を満たす 任意の数である。また重合体の重量平均分子量は200 0~20000である)で示される樹脂、ならびに、★ ★下記一般式(IX): [0051] 【化14】

【0052】(式中、q、r、sは、それぞれq+r+ s=1、0≤q<1、0<r<1、0<s<1を満たす 任意の数である。また重合体の重量平均分子量は200 0~20000である)で示される樹脂などが好まし 50 ることができる。

い樹脂の一例として挙げられる。なお上記の高透明性と 酸触媒に対する反応性を有する限り、ことに具体的に示 すネガ型のレジスト樹脂以外のものも同じく好適に用い

(X)

【0053】また、ネガ型フォトレジスト組成物には、露光部における樹脂の不溶化反応を促進する架橋剤を添加することができる。好ましい架橋剤として、ヘキサメトキシメチルメラミン、1、3、4、6ーテトラキス(メトキシメチル)グリコールウリル、1、3ービス(メトキシメチル)ー4、5ービス(メトキシメチル)ウレア等のユリア・メラミン系架橋剤、ならびに2、3ージヒドロキシー5ーヒドロキシメチルノルボルナン、1、4ーシクロヘキサンジメタノール、3、4、8(9)ートリヒドロキシトリシクロデカン等の多価アルコール等を一例として挙げられる。好適な架橋剤は、これら例示するものに限定されるものではない。また、一種を単独で添加してもよく、あるいは二種類以上を混合して用いてもよい。

13

【0054】なお、本発明のフォトレジスト組成物に は、樹脂やスルホニウム塩化合物などに加えて、適量の 溶剤が含まれる。この溶剤は、上記の樹脂とスルホニウ ム塩化合物からなる成分を均一に溶解し、またそのフォ トレジスト組成物を用いてスピンコート法などの方法で 20 均一な塗布膜が形成可能である限り、いかなる有機溶媒 でもよい。また、溶剤には一種類の有機溶媒を単独で用 いてもよく、二種類以上を混合して用いても良い。具体 的には、n-ブロピルアルコール、イソブロピルアルコ ール、n-ブチルアルコール、tert-ブチルアルコ ールなどのアルコール類、メチルセロソルブアセテー ト、エチルセロソルブアセテート、プロピレングリコー ルモノエチルエーテルアセテート、乳酸メチル、乳酸エ チル、酢酸2-メトキシブチル、酢酸2-エトキシエチ ル、ビルビン酸メチル、ビルビン酸エチル、3-メトキ 30 シプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチ ルなどのエステル類、N-メチル-2-ピロリジノン、 シクロヘキサノン、シクロペンタノン、シクロヘキサノ ールなどの環状ケトン・アルコール類、メチルエチルケ トンなどのケトン類、1,4-ジオキサン、エチレング リコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノ メチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエ チルエーテル、エチレングリコールモノイソプロビルエ ーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジ エチレングリコールジメチルエーテルなどのグリコール 40 エーテル類などが、好ましい溶剤の一例として挙げられ るが、もちろんこれらだけに限定されるものではない。 【0055】また、本発明のポジ型フォトレジスト組成 物及びネガ型フォトレジスト組成物は、その「基本的 な」構成成分は、一般式(1)のスルホニウム塩誘導 体、樹脂、および溶剤であるが、必要に応じて、溶解阻 止剤、架橋剤、塩基性化合物、界面活性剤、色素、安定 剤、塗布性改良剤、染料などの付加的な添加成分を加え るととができる。

【0056】本発明のパターン形成方法は、上記の本発 50 6ml に溶解し、そこにヨウ化メチル10.7gを加え

明のポジ型フォトレジスト組成物またはネガ型フォトレジスト組成物を利用して、フォトレジストの露光に波長 130~220nmの範囲から選択する露光光を用いて、マスクパターンをフォトレジスト塗布膜上に転写形成する方法である。この工程では、フォトレジスト塗布、露光前のベーク処理、露光後のベーク処理、現像の各工程は、従来の化学増幅型レジストを用いるパターン形成と本質的に同じである。また、露光により生成したブロトン酸による酸触媒反応自体も、本質的に従来のトリフェニルスルホニウム塩化合物を光酸発生剤(感光剤)に用いる際と同じである。

[0057]

【実施例】次に、具体例を挙げて、本発明のスルホニウム塩化合物、その製造方法、ならびに係るスルホニウム塩化合物を光酸発生剤として用いるフォトレジスト組成物について、さらに詳細に説明する。また、前記フォトレジスト組成物を利用するパターン形成において、高い解像度が達成できることを具体例により示す。なお、これらの具体例は、本発明の好ましい態様であるが、本発明はこれらの例に、限定されるものではない。

【0058】(実施例1)

下記構造:

[0059]

【化15】

【0060】のスルホニウム塩化合物、すなわち、一般式(I) において、Xがメチレン基(-CH₂-)、R¹がメチル基、R²がシクロヘキシル基、R³、R⁴、R⁴、R⁵、R⁴が水素原子、Y⁻がトリフルオロメタンスルホナートイオンである化合物を、下記の手順で合成した。

【0061】シクロヘキシルメルカブタン5.5gをエタノール50mlに溶解し、そとに水酸化ナトリウム1.97gを加え加熱湿流させる。水酸化ナトリウムが全て溶解したら放冷し、そとに2ーブロモー1ーインダノン(アルドリッチ社製)10gをエーテル20mlに溶解したものを滴下する。室温で3時間撹拌した後、反応混合物を冷水300mlに注ぐ。有機層をエーテル20mlで抽出し、エーテル層を塩化ナトリム水溶液、水の順で洗浄する。エーテル層を硫酸マグネシウムで乾燥後、エーテルを減圧下留去する。残さをシリカゲルカラムで分離精製(溶出液:ヘキサン/酢酸エチル=9/1)するととで2ー(シクロヘキシルチオ)ー1ーインダノン2gをニトロメタンロヘキシルチオ)ー1ーインダノン2gをニトロメタン

室温で撹拌する。1時間後、トリフルオロメタンスルホン酸銀2.09gをニトロメタン40mlに溶解したものを滴下する。室温で18時間撹拌後、析出しているヨウ化銀をろ別し、ろ液を減圧下1/3程度に濃縮する。残渣をエーテル250mlに滴下し、析出したスルホニウム塩をろ別する。さらに酢酸エチルーエタノールから再結することで上記構造のスルホニウム塩を2.42g

15

【0062】融点:122℃

得た(収率73%)。

¹H-NMR (CDC1,): δ (ppm) 1.2-2.36 (10H, m), 2.97, 3.14 (3H, s), 3.62 (1H, dt), 3.88-4.31 (2H, m), 4.77-5.02 (1H, m), 7.4-7.88 (4H, m)

(実施例2)

下記構造:

[0063]

【化16】

【0064】のスルホニウム塩化合物、すなわち一般式(I)において、Xがメチレン基(-CH,-)、R¹がシクロヘキシル基、R¹がノルボルニル基、R¹、R¹、R¹、R¹、R¹、大R¹が水素原子、Y¹がトリフルオロメタンスルホナート イオンである化合物を、下記の手順で合成した。

【0065】実施例1 に記載する手順に従い、2-(シクロヘキシルチオ)-1-インダノンを合成する。次いで、ヨウ化メチルに代えて、2-ブロモノルボルナンを用いて同様の手順で合成した(収率9%)。融点:99℃。

【0066】(実施例3)

下記構造:

[0067]

【化17】

【0068】のスルホニウム塩化合物、すなわち一般式 化メチルに代えて、ブロモエタンを用いて、| (1)において、Xがメチレン基(-CH'-)、R'、 50 で合成した(収率14%)。融点:166℃

R³がメチル基、R³、R⁴、R⁴、R⁵が水素原子、Y²が トリフルオロメタンスルホナート イオンである化合物 を、下記の手類で合成した。

16

【0069】2-ブロモ-1-インダノン10gをエタノール50ml に溶解する。そこにメチルメルカブタンナトリウム塩の15%水溶液25mlを滴下する。そして室温で3時間撹拌した後、反応混合物を冷水300mlに注ぐ。有機層をエーテル200mlで抽出し、エーテル層を塩化ナトリム水溶液、水の順で洗浄する。エープル層を硫酸マグネシウムで乾燥後、エーテルを減圧下留去する。残渣をシリカゲルカラムで分離精製(溶出液:ヘキサン/酢酸エチル=7/1)することで2-(メチルチオ)-1-インダノンを3.2g得た(収率38%)。

【0070】次に2-(メチルチオ)-1-インダノン2gをニトロメタン10mlに溶解し、そこにヨウ化メチル14gを加え室温で撹拌する。1時間後、トリフルオロメタンスルホン酸銀2.88gをニトロメタン60mlに溶解したものを滴下する。室温で16時間撹拌20後、析出しているヨウ化銀をろ別し、ろ液を減圧下1/3程度に濃縮する。残渣をエーテル200mlに滴下し、析出したスルホニウム塩をろ別する。さらにスルホニウム塩をアセトンに溶解し、エーテル中に再沈させる。その後、酢酸エチルーエタノールから再結することで上記構造のスルホニウム塩を2.95g得た(収率80%)。

【0071】融点:132℃

¹H-NMR (THF-d₁): δ (ppm) 3. 14 (3H, s), 3. 20 (3H, s), 3. 74-3. 0 95 (2H, m), 4. 87-5. 02 (1H, m), 7. 38-7. 85 (4H, m)

(実施例4)

下記構造:

[0072]

【化18】

40

【0073】のスルホニウム塩化合物、すなわち一般式(1)において、Xがメチレン基(-CH,-)、R¹がエチル基、R²がメチル基、R³、R⁴、R⁴、R⁶が水素原子、Y⁻がトリフルオロメタンスルホナート イオンである化合物を、下記の手順で合成した。

【0074】実施例3に記載する手順に従い、2-(メ チルチオ)-1-インダノンを合成する。次いで、ヨウ 化メチルに代えて、ブロモエタンを用いて、同様の手順 で合成した(収率14%)。 融点:166℃

(実施例5)

下記構造:

[0075]

【化19】

17

【0076】のスルホニウム塩化合物、すなわち一般式(I)において、Xがメチレン基(-CH,-)、R¹がメチル基、R³がノルボルニル基、R³、R⁴、R⁵、R⁵が水素原子、Y⁻がトリフルオロメタンスルホナートイオンである化合物を、下記の手順に従い合成した。【0077】実施例3に記載する手順に従い、2-(メチルチオ)-1-インダノンを合成する。次いで、ヨウ化メチルに代えて2-ブロモノルボルナンを用いて、同様の手順で上記構造のスルホニウム塩を合成した(収率48%)。

【0078】融点:102℃

¹H-NMR (CDC1,): δ (ppm) 1. 16-2. 12 (8H. m), 2. 26-2. 76 (2H. m), 2. 99, 3. 13 (3H. s), 3. 54-3. 8 (1H. m), 3. 84-4. 34 (2H. m), 4. 72-5. 04 (1H. m), 7. 41-7. 9 (4H. m)

(実施例6)

下記構造:

[0079]

【化20】

【0080】のスルホニウム塩化合物、すなわち一般式(I)において、Xがメチレン基(-CH₂-)、R¹、R¹が結合した二価の基(-R¹-R²-)であるペンタメチレン基、R¹、R¹、R¹、R²が水素原子、Y²が臭化物イオンである化合物を、下記の手順で合成した。【0081】2-ブロモー1-インダノン3.44gをアセトン20m1と水1m1の混合溶液に溶解し、そこにペンタメチレンスルフィド1.5gを加え室温で4日間撹拌する。析出したスルホニウム塩をろ別し、さらにメタノールに溶解し、エーテル中に再沈精製することで上記構造のスルホニウム塩を1.75g得た(収率38%)。分解点:122℃

(実施例7)

下記構造: 【0082】 【化21】

【0083】のスルホニウム塩、すなわち一般式(I)において、Xがメチレン基(-CH,-)、R¹、R²が結合した二価の基(-R¹-R²-)であるペンタメチレン基、R²、R⁴、R⁴が水素原子、R⁵がメトキシ基、Y²が臭化物イオンである化合物を、下記の手順で合成した。

【0084】実施例6に記載する手順に従い、2-ブロモー1-インダノンに代えて、2-ブロモー5-メトキシー1-インダノン(W.S.Johnson6、J.Am.Chem.Soc.,66巻、218-220頁(1944年))を用いて、上記構造のスルホニウム塩を合成した(収率30%)。分解点:144℃(実施例8)

下記構造:

[0085]

【化22】

30

C₄F₆SO₃

【0086】のスルホニウム塩化合物、すなわち一般式(1) において、Xがメチレン基(-CH,-)、R¹、R¹が結合した二価の基(-R¹-R²-) であるペンタメチレン基、R¹、R¹、R¹、R²が水素原子、Y²がノナフルオロブタンスルホナートイオンである化合物を、下記の手順で合成した。

【0087】実施例6で得たスルホニウム塩1.5gを水12mlに溶解し、そこにノナフルオロブタンスルホ 2mlに溶解した62gを水50mlに溶解したものを加え室温で撹拌する。3時間後析出した塩を濾別し水で洗浄する。次に塩をアセトンに溶解し、エーテル中に再沈させ、析出した塩をろ別する。その後、酢酸エチルーエタノール混合溶媒から再結することで、上記構造のスルホニウム塩を1.72g得た(収率67%)。

【0088】融点:175℃

¹H-NMR (アセトンーd_{*}): δ (ppm) 1.7 -1.96 (2H, m)、2.0-2.16 (2H, m)、2.29-2.53 (2H, m)、3.73-50 4.06 (6H, m)、5.21 (1H, dd)、7.

19

5-7.89(4H, m)

(実施例9)

下記構造:

[0089]

【化23】

【0090】のスルホニウム塩化合物、すなわち一般式(I) において、Xがメチレン基(-CH,-)、R¹、R¹が結合した二価の基(-R¹-R²-)であるテトラメチレン基、R¹、R⁴、R⁴、R⁵、R⁶が水素原子、Y⁻が臭化物イオンである化合物を、下記の手順で合成した。

【0091】実施例6に記載する手順に従い、ペンタメチレンスルフィドに代えて、テトラヒドロチオフェンを用いて、上記構造のスルホニウム塩を合成した(収率33%)。分解点:116℃

(実施例10)

下記構造:

[0092]

【化24】

【0093】のスルホニウム塩化合物、すなわち一般式 (I) において、Xがメチレン基(-CH,-)、R¹、 R¹が結合した二価の基(-R¹-R²-)であるテトラ メチレン基、R¹、R¹、R¹、R²が水素原子、Y²がノ ナフルオロブタンスルホナートイオンである化合物を、 下記の手順で合成した。

【0094】先ず、実施例9のスルホニウム塩を合成する。その後、実施例8に記載されている対イオン交換反応に準じて、ノナフルオロブタンスルホン酸カリウムを利用して、臭化物イオンをノナフルオロブタンスルホナ 40 ート イオンに交換して、上記構造のスルホニウム塩を合成した(収率40%)。

【0095】融点:156℃

¹H-NMR (アセトン-d_•): δ (ppm) 2. 3 5-2. 71 (4H, m), 3. 65-3. 84 (1 H, m), 4. 18-4. 35 (1H, m), 4. 93 (1H, dd), 7. 49-7. 91 (4H, m)

(実施例11)

[0096]

下記構造:

【化25】

【0097】のスルホニウム塩化合物、すなわち一般式 (I) において、Xがメチレン基(-CH,-)、R¹、 10 R¹が結合した二価の基(-R¹-R²-)であるテトラ メチレン基、R¹、R⁴、R⁵、R⁶が水素原子、Y⁻がへ ブタデカフルオロオクタンスルホナート イオンである 化合物を、下記の手順で合成した。

【0098】先ず、実施例9のスルホニウム塩を合成する。その後、実施例8に記載される対イオン交換反応に進じて、ヘブタデカフルオロオクタンスルホン酸カリウムを用いて、臭化物イオンをヘブタデカフルオロオクタンスルホナート イオンに交換して合成した(収率32%)。

20 【0099】融点:145℃

¹H-NMR (アセトン-d₆): δ (ppm) 2.3 5-2.71 (4H, m)、3.65-3.84 (1 H, m)、4.18-4.35 (1H, m)、4.93 (1H, dd)、7.49-7.91 (4H, m) (実施例12)

下記構造:

[0100]

【化26】

30

【0101】のスルホニウム塩化合物、すなわち一般式(1)において、Xがメチレン基(-CH,-)、R¹、R¹がメチル基、R¹、R⁴、R⁶が水素原子、R¹がメトキシ基、Y²がトリフルオロメタンスルホナート イオンである化合物を、下記の手順で合成した。

40 【0102】2-ブロモ-5-メトキシ-1-インダノン(W. S. Johnsonら、J. Am. Chem. Soc., 66巻、218-220頁(1944年))5gをアセトン30mlに溶解し、そこにジメチルスルフィド1.29gを加え、室温で7日間撹拌する。析出した塩をろ別する。さらに塩をメタノールに溶解し、エーテル中に再沈することで臭化物塩1.73gを得た(収率28%)。次に臭化物塩1.5gを水10mlに溶解し、そこにトリフルオロメタンスルホン酸カリウム0.931gを水5mlに溶解したものを滴下し、室温50で2時間撹拌する。析出した塩をろ別し、アセトン-エ

タノールで再沈精製した後、さらに、酢酸エチルーエタ ノール混合溶媒で再結することで、上記スルホニウム塩 を0.83 g得た(収率45%)。融点:135℃ (実施例13)

下記構造:

[0103]

[化27]

【0104】のスルホニウム塩化合物、すなわち一般式 (I) において、Xが-OCH₂-、R¹、R²がメチル 基、R¹、R¹、R¹、R¹が水素原子、Y⁻がトリフルオ ロメタンスルホナート イオンである化合物を、下配の 手順で合成した。

【0105】3-プロモ-4-クロマノン(W.S.J ohnsonb, J. Am. Chem. Soc., 66 巻、218-220頁(1944年)記載の方法に準じ て、4-クロマノンから合成した。) 10.4gをエタ ノール42m1に溶解し、そこにメチルメルカプタンナ トリウム塩の15%水溶液21.3mlを滴下する。そ して室温で2時間撹拌した後、反応混合物を冷水300 m1に注ぐ。有機層をエーテル200m1で抽出し、エ ーテル層を塩化ナトリム水溶液、水の順で洗浄する。エ ーテル層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留 去する。残渣をシリカゲルカラムで分離精製(溶出液: チオー4-クロマノンを1.52g得た(収率17 %)。

【0106】次に3-メチルチオー4-クロマノン1. 48gをニトロメタン8m1に溶解する。そこにヨウ化 メチル9. 73gを加え室温で撹拌する。1時間後、ト リフルオロメタンスルホン酸銀1.958gをニトロメ タン40m1に溶解したものを滴下する。室温で20時 間撹拌後、析出しているヨウ化銀をろ別し、ろ液を減圧 下1/3程度に濃縮する。残渣をエーテル200mlに 滴下し、析出したスルホニウム塩をろ別する。さらにス 40 【0111】融点:130℃ ルホニウム塩をアセトンに溶解し、エーテル中に再沈さ せる。そして酢酸エチルーエタノールから再結すること で上記構造のスルホニウム塩を1.77g得た(収率6 5%)。融点:113℃

(実施例14)

下記構造:

[0107]

【化28】

【0108】のスルホニウム塩化合物、すなわち一般式 (I) において、Xがエチレン基(-C,H,-)、 R¹、R²がメチル基、R³、R⁴、R°が水素原子、R³が 10 メトキシ基、Y⁻がトリフルオロメタンスルホナート イオンである化合物を、下記の手順で合成した。 【0109】2-ブロモー6-メトキシー1-テトラロ ン(W. S. Johnson5、J. Am. Chem. Soc., 66巻、218-220頁(1944年)記 載の方法に準じて、6-メトキシ-1-テトラロンより 合成した。) 20gをテトラヒドロフラン100mlに 溶解し、そこにメチルメルカプタンナトリウム塩の15 %水溶液36.5gを滴下する。そして室温で3時間撹 拌した後、反応混合物を冷水300m1に注ぐ。有機層 20 をエーテル200mlで抽出し、エーテル層を塩化ナト リム水溶液、水の順で洗浄する。エーテル層を硫酸マグ ネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去する。残渣をヘキ サン/酢酸エチル7/1混合溶媒320m1に溶解し、 そとにシリカゲルを加え不純物を吸着させる。シリカゲ ルをろ別し、ろ液を減圧下濃縮することで6-メトキシ -2-(メチルチオ)-1-テトラロンを11.06g 得た(収率64%)。

【0110】次に6-メトキシ-2-(メチルチオ)-1-テトラロン4gをニトロメタン20m1に溶解す ヘキサン/酢酸エチル=3/1) することで3-メチル 30 る。そこにヨウ化メチル22.998を加え室温で撹拌 する。1時間後、トリフルオロメタンスルホン酸銀4. 623gをニトロメタン100mlに溶解したものを滴 下する。室温で16時間撹拌後、析出しているヨウ化銀 をろ別し、ろ液を減圧下1/3程度に濃縮する。残渣を エーテル200m1に滴下し、析出したスルホニウム塩 をろ別する。さらにスルホニウム塩をアセトニトリルに 溶解し、エーテル中に再沈させる。そして酢酸エチルー アセトニトリルから再結することで上記構造のスルホニ ウム塩を4.09g得た(収率59%)。

'H-NMR (アセトン-d_s): δ (ppm) 2.4 9-2.63(1H, br), 3.12-3.17(3)H. m), 3. 29 (6H, s), 3. 93 (3H, s), 5. 28 (1H, dd), 6. 9-7. 07 (2 H, m), 7. 96 (1H, d)

(実施例15)

下記構造: [0112]

【化29】

【0113】のスルホニウム塩化合物、すなわち一般式 (I) において、Xがエチレン基(-C,H,-)、 R¹、R²がメチル基、R³、R¹、R°が水素原子、R³が メトキシ基、Y⁻がノナフルオロブタンスルホナート イオンである化合物を、下記の手順で合成した。

【0114】実施例14で合成した6-メトキシ-2-(x+y+x) - 1 - x + y + 0ニトリル30mlに溶解する。そとに氷冷下、ノナフル オロブタンスルホン酸メチル6. 54gをアセトニトリ ル10m1 に溶解したものを滴下する。冷蔵庫で一晩放 置後、エーテル250m1中に注ぐ、析出した塩をろ別 する。そして塩をアセトニトリルに溶解し、エーテル中 に再沈させ、さらにろ別した塩を酢酸エチルーアセトニ 塩を6.33g得た(収率57%)。

【0115】融点:143℃

¹H-NMR (アセトン-d₆): δ (ppm) 2.4 9-2.63(1H, br), 3.12-3.17(3* *H. m), 3. 29 (6H, s), 3. 93 (3H, s), 5. 28 (1H, dd), 6. 9-7. 07 (2 H, m), 7. 96 (1H, d) (実施例16)

(スルホニウム塩の透明性の評価) 本発明のスルホニウ ム塩化合物の波長130nm~220nmの境勢外から 真空紫外の領域における透明性の評価を行った。

【0116】実施例1で得たスルホニウム塩3.1mg をアセトニトリル25m1に溶解し、この溶液を用い光 10 路長1mmの石英セルを利用して、紫外可視分光光度計 (島津製作所製UV-365)を用いて吸収スペクトル を測定した。測定された吸光度から、193.4nm (ArF光の波長) に対するモル吸光係数を求めた。同 様にして、実施例3、4、8、10、13、及び14で 得られたスルホニウム塩、並びに従来光酸発生剤に用い られているトリフェニルスルホニウム トリフルオロメ タンスルホナート (TPS) (みどり化学 (株) 製 T PS-105) に関してもモル吸光係数を求めた。表1 に、求まったモル吸光係数示す。表1に示すように、本 トリル混合溶媒より再結するととで、上記スルホニウム 20 発明のスルホニウム塩化合物は従来のトリフェニルスル ホニウム塩に比べ、ArF光に対する吸収が小さく、透 明性に優れていることが示された。

> [0117]【表1】

スルホニウム塩化合物	193.4nmでのモル吸光係数 (1·mol ⁻¹ ·cm ⁻¹)			
実施例 1のスルホニウム塩	16980			
実施例3のスルホニウム塩	16052			
実施例4のスルホニウム塩	17479			
実施例8のスルホニウム塩	16441			
実施例10のスルホニウム塩	17419			
実施例14のスルホニウム塩	14149			
TPS: (C,H,),S* CF,SO,"	54230			

【0118】(実施例17)

(スルホニウム塩を用いたポジ型レジストのパターニン グ評価) 下記の(a) 樹脂、(b) 光酸発生剤、(c) 溶剤組成からなるレジストを調製した。

※【0119】(a) 下記構造の樹脂: 2g

[0120]

【化30】

【0121】(b)光酸発生剤:実施例3で得たスルホ ニウム塩: 0. 02g

(c) プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテ -h:11.5g

前記の混合物を0.2μmのテフロンフィルターを用い

上に前記レジストをスピンコート塗布し、130℃1分 間ホットブレート上でベークし、膜厚0. 4μmの薄膜 を形成した。そして窒素で充分パージされた密着型露光 実験機中に、レジストをコートしたウェハーを静置し

てろ過し、レジストを調製した。4インチシリコン基板 50 【0122】石英板上にクロムでバターンを描いたマス

クをレジスト膜上に密着させ、そのマスクを通してAr Fエキシマレーザ光を照射した。その後、すぐさま11 0℃、60秒間ホットプレート上でベークし、液温23 ℃の2. 38%TMAH ((CH₁) ,NOH) 水溶液で 60秒間浸漬法による現像をおこない、続けて60秒間 純水でリンス処理をそれぞれおこなった。その結果、レ ジスト膜の露光部分のみが現像液に溶解除去されポジ型 のパターンが得られた。同様にして実施例10、13、 14で得たスルホニウム塩、並びに比較例としてトリフ*

* ェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホナート (TPS)を光酸発生剤に用いたレジストについても評 価した。表2に、感度および解像度の結果を示す。表2 に示す結果から、本発明のスルホニウム塩化合物を用い たポジ型フォトレジスト組成物は優れた解像特性を有す ることが分かる。

26

[0123]

【表2】

光酸発生剤	解像度(μ m·L/S)	感度 (mJ/cm²)
実施例3のスルホニウム塩	0.18	6
実施例10のスルホニウム塩	0.17	6, 5
実施例13のスルホニウム塩	0.17	5. 5
実施例14のスルホニウム塩	0.17	5. 5
TPS: (C,H,),S ⁺ CF,SO, ⁻	0.19	6. 5

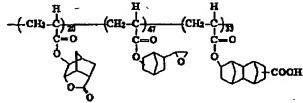
【0124】(実施例18)

(スルホニウム塩を用いたネガ型レジストのパターニン グ評価) 下記の(a) 樹脂、(b) 光酸発生剤、(c) 架橋剤および(d)溶剤の組成からなるレジストを調製※ ※した。

【0125】(a) 下記構造の樹脂:2g

[0126]

【化31】



【0127】(b)光酸発生剤;実施例3で得たスルホ ニウム塩:0.04g

(c) 2, 3-ジヒドロキシ-5-ヒドロキシメチルノ ルボルナン: 0.3 g

(d)乳酸エチル:11.5g

前記の混合物を0.2μmのテフロン(登録商標)フィ ルターを用いてろ過し、レジストを調製した。 4 インチ シリコン基板上に前記レジストをスピンコート塗布し、 80℃1分間ホットブレート上でベークし、膜厚0.4 μπの薄膜を形成した。そして窒素で充分パージされた 密着型露光実験機中に、レジストをコートしたウェハー を静置した。

【0128】石英板上にクロムでパターンを描いたマス クをレジスト膜上に密着させ、そのマスクを通してAェ 40 【表3】 Fエキシマレーザ光を照射した。その後すぐさま130★

★°C、60秒間ホットプレート上でベークし、液温23°C の2.38%TMA H水溶液で60秒間浸漬法による現 像をおこない、続けて60秒間純水でリンス処理をそれ 30 ぞれおこなった。この結果、レジスト膜の未露光部分の みが現像液に溶解除去されネガ型のパターンが得られ た。同様にして実施例10、13および14で得たスル ホニウム塩、並びに比較例としてトリフェニルスルホニ ウム トリフルオロメタンスルホナート (TPS) を用 いたネガ型レジストについても評価した。表3に、感度 および解像度の結果を示す。表3に示すように、本発明 のスルホニウム塩化合物を用いたネガ型フォトレジスト 組成物は優れた解像特性を有することが分かる。

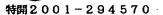
[0129]

光酸発生剤	解像度 (μ m·L/S)	感度 (mJ/cm²)
実施例3のスルホニウム塩	0.18	5
実施例10のスルホニウム塩	0.17	6
実施例13のスルホニウム塩	0.18	4. 5
実施例14のスルホニウム塩	0.18	4. 5
TPS: (C,H,),S+ CF,SO,-	0.19	6.8

[0130]

【発明の効果】本発明のスルホニウム塩化合物は、1-オキソインダン-2-イル基などを用いる構造であるの 50 て、本発明のスルホニウム塩化合物を光酸発生剤に用い

で、波長130mm~220mmの遠紫外から真空紫外 の領域における透明性に優れた光酸発生剤となる。従っ



るフォトレジスト組成物は、ArFエキシマーレーザな *り、半導体素子製造に必要な微細パターン形成が可能と どの波長130nm~220nmの遠紫外から真空紫外 の領域の露光光に対する感度、解像度に優れたものとな*

27

なる。

フロン	トペー	ジの続き
-----	-----	------

7471-1-7	V)868				
(51)Int.Cl.'	識別記号	F	I	7	72-ド(参考)
G03F	7/038 6 0 1	G 0	3 F 7/038	601	
	7/039 6 0 1		7/039	601	
HO1L 2	21/027	Н 0	1 L 21/30	502R	
		,			
(72)発明者 中	野 嘉一郎	Fタ	ーム(参考) 2	H025 AA01 AB16 AC03	AC04 AC08
東	京都港区芝五丁目7番1号	日本電気株		AD01 AD03 BE07	BE10 BG00
左	式会社内			CB41 CC17	
(72)発明者 長	長谷川 悦雄		4	C023 JA05	
東	東京都港区芝五丁目7番1号	日本電気株	4	C062 EE44	
左	代会社内		4	H006 AA01 AA03 AB92	